



## 台積公司與聯發科技延續超低功耗技術合作以掌握新興物聯網市場商機

發佈單位：聯發科技、台灣積體電路製造股份有限公司

發佈日期：2016 年 3 月 15 日

台積公司與聯發科技今（15）日共同宣布雙方長期合作夥伴關係的承諾，未來將持續利用台積公司業界領先且最完備的超低耗電技術平台來開發支援物聯網及穿戴式裝置的創新產品。台積公司透過此技術平台提供多項製程技術來大幅提升功耗優勢以支援物聯網及穿戴式產品，同時也提供完備的設計生態環境，加速客戶產品上市時間。

聯發科技與台積公司合作，利用此技術平台於今年一月推出首款產品MT2523，MT2523系列採用台積公司55奈米超低功耗技術生產，是專為運動及健身用智慧手錶所設計的解決方案，也是全球首款高度整合GPS、雙模低功耗藍牙，同時支持高解析度MIPI顯示螢幕的系統級封裝（SiP）晶片解決方案。

聯發科技副總經理暨物聯網事業部總經理徐敬全表示：「我們很高興能夠延續 MT2523 平台的成功，並且採用超低功耗技術與台積公司合作開發領先市場的物聯網及穿戴式產品。」

台積公司業務開發副總經理金平中博士表示：「台積公司提供的 55 奈米超低耗電製程（55ULP）、40 奈米超低耗電製程（40ULP）、28 奈米高效能精簡型強效版製程（28HPC+）、以及 16 奈米 FinFET 強效版製程（16FF+）皆適用於各種具有節能效益的智慧型物聯網及穿戴式產品，聯發科技憑藉優異的創新能力提供終端客戶最佳的解決方案，而雙方的合作讓台積公司超低功耗技術繼續往前邁進，實現最佳且最具競爭力的物聯網產品解決方案。」

### 關於台積公司

台積公司（TSMC）是全球最大的專業積體電路製造服務公司，提供業界卓越的製程技術、



元件資料庫、設計參考流程及其他先進的晶圓製造服務。於二零一五年間台積公司提供足以生產相當於超過900萬片十二吋晶圓的產能，其中包括三座先進的GIGAFAB™；十二吋晶圓廠（晶圓十二廠、晶圓十四廠及晶圓十五廠）、四座八吋晶圓廠（晶圓三、五、六及八廠）、一座六吋晶圓廠（晶圓二廠）。此外，台積公司亦有來自其轉投資子公司美國WaferTech公司以及台積電（中國）有限公司充沛的產能支持。台積公司係首家提供20奈米及16奈米製程技術為客戶生產晶片的專業積體電路服務公司。其企業總部位於臺灣新竹。進一步資訊請至台積公司網站[www.tsmc.com.tw](http://www.tsmc.com.tw)查詢。

## 關於聯發科技

聯發科技成立於1997年，透過持續投資先進製程與前瞻技術，現已成長為全球領先的IC設計公司，提供涵蓋無線通訊、無線連結、智慧電視、DVD及藍光等多個領域的系統晶片整合解決方案(SoC)。聯發科技提供高度整合與具備創新性的晶片設計方案，不僅協助製造商優化供應鏈及縮短新產品開發時間，還利於其在全球成熟及發展中市場建立競爭優勢。進入物聯網時代，聯發科技成立創意實驗室(MediaTek Labs)，提供產品及技術支援，協助全球開發者設計、開發物聯網相關裝置、應用與服務。聯發科技致力讓科技惠及每個人，希望透過聯發科技的技術讓所有人都能與世界連結，拓展視野和實現目標。我們相信科技能夠激發人們的內在潛力，每個人皆可創造無限可能 (Everyday Genius)。瞭解更多資訊，請瀏覽[www.mediatek.com](http://www.mediatek.com)。

聯發科技新聞聯絡人：  
李欣茹  
Tel: 03-567-0766 # 31602  
E-Mail: joey.lee@mediatek.com

台積公司發言人：  
何麗梅  
資深副總經理暨財務長  
Tel: 03-505-4602

台積公司代理發言人：  
孫又文  
企業訊息處 資深處長  
Tel: 03-568-2085  
Mobile: 0988-937-999  
E-Mail: elizabeth\_sun@tsmc.com